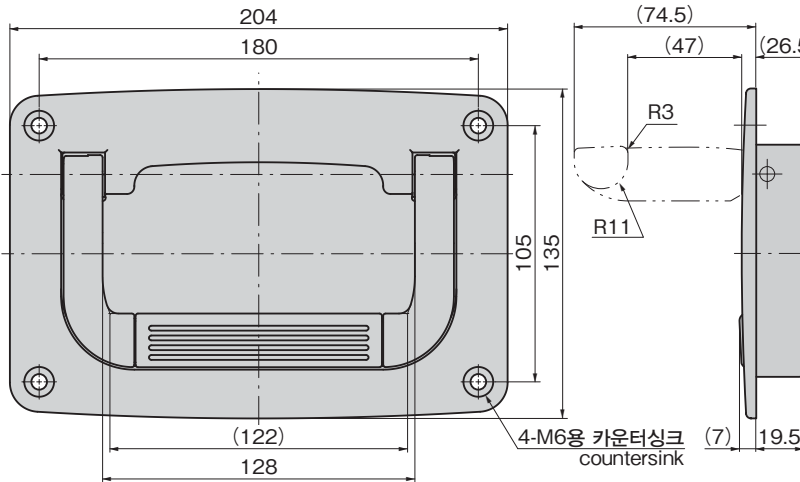
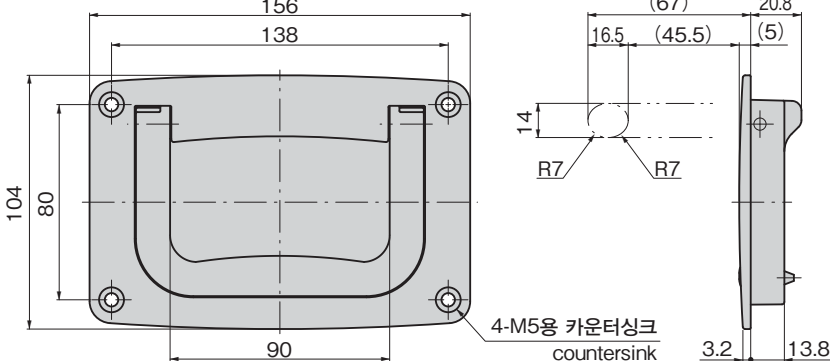


2018년도판 SEMI 규격 준거
2018 edition SEMI-compliantA-89N-1-Silver
실버A-89N-2-Silver
실버A-89N-3-Silver
실버

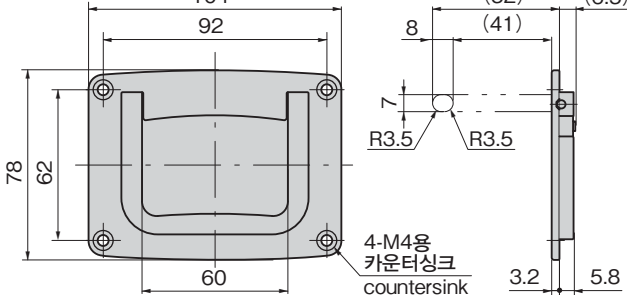
[A-89N-1]



[A-89N-2]



[A-89N-3]



참고 기사



활용 방법을 비롯하여
개발 비화를
게재하였습니다.

특징 Feature

- SEMI S8-0218(SESC6.7) 대응(2018년도판)
- 기존에 사용했던 핸들을 케이스의 설계를 변경하지 않고 새로운 SEMI 규격에 대응하기 위해 손잡이의 베이스는 그대로 두고 그립 부분만 변경했습니다.
- 손가락과의 접촉면이 R 형상으로 되어 있어 조작 시의 부담을 경감합니다.
- 손잡이는 열림 또는 닫힘의 어느 위치에서도 유지합니다. (A-89N-3은 닫힐 때만)
- Compliant with SEMI S8-0218 (SESC 6.7) (2018 edition)
- Only the grip portion was changed and the base of the handle was left as it is, to allow handles that have always been used to be made compliant with SEMI standards without any changes to the casing design.
- Rounded grip surface reduces load on fingers when gripping.
- Handle held at both opened and closed positions. (A-89N-3 at closed position only)

사양

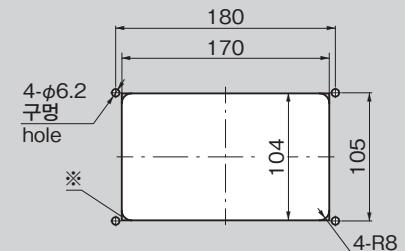
[A-89N-1]	● 재질: 본체/알루미늄 합금(ADC) 그립/엘라스토머 수지
[A-89N-2·3]	● 재질: 본체/아연합금(ZDC) 표면 마무리: 열처리 도장(실버 메탈릭)
용도	● 반도체 제조장치

Specifications

[A-89N-1]	● Material: Main body: Aluminum alloy (ADC) Grip: Elastomer resin
[A-89N-2·3]	● Finish: Baked (silver metallic)
[A-89N-2·3]	● Material: Main body: Zinc alloy (ZDC)
[A-89N-2·3]	● Finish: Baked (silver metallic)
Specific use	● Semiconductor production equipment

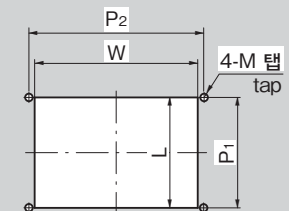
패널 구멍 치수(1/2)
Panel drilling dimensions

[A-89N-1]



※부의 4 모서리를 패널 구멍으로 하고, M6 탭으로 한 경우에도 부착할 수 있습니다.
Installation also possible even if corners indicated with "※" are cut away and tapped with M6 holes.

[A-89N-2·3]



※클린룸용 장갑 장착 시의 보수 하중 SEMI S8-0218(SESC6.7) 대응(2018년도판)

※ Compliant with conservative load SEMI S8-0218 (SESC 6.7) (2018 edition) when wearing clean room gloves.

상품 번호 Product No.	RoHS 10	L	W	P ₁	P ₂	M	※보수 하중(N) Conservative load		사용 하중 N Working load	제품질량(g) Mass	코드 Code
A-89N-1-Silver	●	도면 참조 See the drawings					MAX. 88	MAX. 294	490	610	04706
A-89N-2-Silver	●	86	127	80	138	5			392	625	04737
A-89N-3-Silver	●	64	83	62	92	4	MAX. 24		50	180	04738

●: RoHS10 대응품 ▲: RoHS10에 대응 가능합니다.